

**PCN#20140903000**  
**PBGA/nFBGA パッケージ一部製品 TI-Philippines(TIPI)組立サイト追加認定**

お客様各位

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、**30** 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけただけのものとして判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 **30** 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知 **Page 3** 記載の変更実施予定日 (**proposed 1<sup>st</sup> ship date**) 以降に予定いたしております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは [pcn\\_tij@list.ti.com](mailto:pcn_tij@list.ti.com) にお問い合わせ下さい。

以上

---

PAGE 2:

**Attachment: 1**

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。変更内容詳細は下記を参照ください。

<b>PCN 番号:</b>	20140903000			<b>PCN 日付:</b>	09/11/2014	
<b>表題:</b>	PBGA/nFBGA パッケージ一部製品 TI-Philippines(TIPI)組立サイト追加認定					
<b>PCN 詳細</b>						
<b>変更内容:</b>						
PBGA/nFBGA パッケージ 一部製品について、追加組立サイトとして TI-Philippines (TIPI)サイトの認定を連絡します。組立の相違は下記の通りです。						
<b>Group 1 Devices:</b>						
BGA Package Type	StatsChipPac Korea (CPK)			TI Philippines (TIPI)		
	Mount Compound	Mold Compound	Wire Type (mil)	Mount Compound	Mold Compound	Wire Type (mil)
GDP	R008-0022A	R005-B057	1.0 Au	4205412	4208515 / 4206745	0.80 Cu
ZDP						
ZDW	R008-0022A	R003-0088A				
ZAU	R008-0023A	R003-0035B	1.0 Au	4205412	4206745	0.96 Au
ZRH	R007-0045	R005-A074				
ZEN	R008-0022A	R003-0076E				
ZLS	R008-0052B (Bottom die) R008-0249B (Top die)	R003-0429K	0.80 Au	4205412 (Bottom die) 4211732 (Top die)	4206745	0.80 Au
ZJA	R008-0052B	R003-0035H	0.9 Au	4205412	4208515	0.9 Au
ZWQ	R008-0022A	R003-0035E	1.0 Au			0.96 Au
<b>Group 2 Devices:</b>						
BGA Package Type	StatsChipPac Korea (CPK)			TI Philippines (TIPI)		
	Mount Compound	Mold Compound	Wire Type (mil)	Mount Compound	Mold Compound	Wire Type (mil)
GDY	R008-0022A	R003-0029A	1.0 Au	4205412	4218745	0.80 Cu
ZDY	R008-0022A	R003-0029A	1.0 Au			0.80 Cu
ZEL	R008-0022A	R003-0076C	1.0 Au			0.96 Au
ZEU	R008-0022A	R003-0076C	0.9 Au			0.9 Au
ZED	R008-0022A	R003-0029A	1.0 Au			0.80 Cu
ZPA	R008-0022A	R003-0029C	1.0 Au			0.80 Cu
ZWZ	R008-0022A	R003-0452A	1.0 Au			0.8 Cu
<b>Group 3 Devices:</b>						
BGA Package Type	StatsChipPac Korea (CPK)			TI Philippines (TIPI)		
	Mount Compound	Mold Compound	Wire Type (mil)	Mount Compound	Mold Compound	Wire Type (mil)
ZWC	R008-0022A	R003-0035B	1.0 Au	4205412	TBD	0.80 Cu

• **Other Noticeable Package Difference on some devices by Group:**

- Group 1 Devices as follows:

**CPK**



19x19 Wizard-ZEL for reference purposes

**TIPI**



15x15 TLK3132ZEN actual TIPI unit

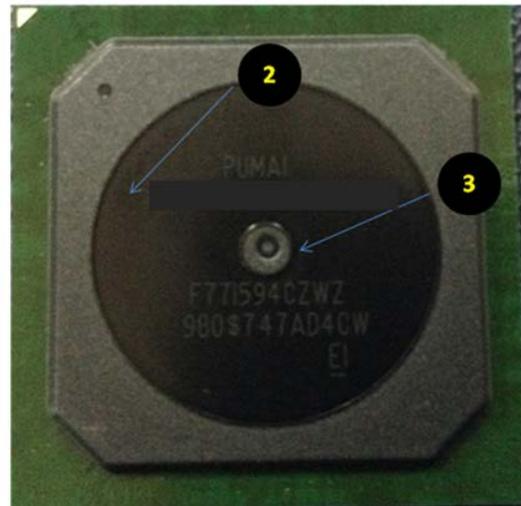
- Heat slug color is black.

- Group 2 Devices as follows:

**CPK**



**TIPI**



TIPI:

- Pin 1 indicator is a small triangle.
- Heat slug is color black.
- Heat slug has hole in center for top gate.

CPK	TIPI
 <p>OMAP™ OMAP5910JG0Y2 4J-41P0748</p>	 <p>OMAP™ OMAP5910JG0Y1 4J-49A6ENW</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pin 1 indicator is a small triangle.</li> <li>▪ Has indentation on center for top gate.</li> </ul>
<b>変更理由 :</b>	
StatsChipPac Korea 社より現行サイトにおいて製造できない旨連絡がありました。	
<b>外観, 寸法, 機能, 品質, 信頼性(positive/negative)に関する懸念事項 :</b>	
なし	

## 注記)

1. 本資料は英語原文(一部)の日本語訳になりますが、TIの公式文書はあくまで英語原文になります。英語原文と日本語訳に齟齬がある場合には、英語原文が優先されます。
2. 上記項目以外、本資料に日本語訳が記載されていない項目については英語原文を参照ください。

## 原文のみ記載の項目例 :

- Proposed 1st Ship Date (変更品出荷開始予定日)
- Last date to order/Last date to ship (最終受注日/最終出荷日)
- Estimated Sample Availability (サンプル入手可能予定時期)
- Change Type (変更項目タイプ)
- Changes to product identification resulting from this PCN (本変更による製品識別の変更)
- Product Affected (対象製品)
- Qualification Data (認定試験データ)
- Appendix (付属資料) 等